

中信证券股份有限公司

关于中微半导体设备（上海）股份有限公司

使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147号），同意公司向不超过35名特定投资者发行股份不超过6,300,932股（含本数，以下简称“本次发行”）的注册申请。公司向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）5,156,765股，每股发行价人民币290.88元，募集资金总额为人民币1,499,999,803.20元，扣除本次发行费用人民币10,118,562.20元，实际募集资金净额为1,489,881,241.00元。上述资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2026）第0016号）。

二、募集资金投资项目情况

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，根据披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	占募集配套资金比例
1	高端半导体设备产业化项目	38,338.89	25.56%
2	高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	23.14%
3	支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	4.64%
4	补充流动资金	70,000.00	46.67%
合计		150,000.00	100.00%

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的情况

公司募投项目（高端半导体设备产业化项目、高端半导体设备研发中心项目）的实施主体为控股子公司上海众硅，公司拟向其提供不超过73,041.47万元的借款用于上述项目实施。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，一次或分次逐步向子公司提供借款。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率将参考同期市场利率，由双方协商确定。

本次公司提供的借款将存放于子公司开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款对象的基本情况

1、基本情况

公司名称	众硅电子科技（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	GU HAIYANG
注册资本	500万元
成立日期	2022-02-14
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年度 /2025.12.31	102,212.56	75,280.39	24,411.88	-9,250.00

五、本次提供借款对公司的影响及风险防范措施

公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款，是基于募集资金投资项目实施需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

上海众硅是公司的控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。公司将加强对上海众硅的经营管理的监督，控制资金风险保障资金安全。

六、本次提供借款后募集资金的使用和管理

为确保募集资金使用安全，公司和上海众硅已与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储监管协议对募集资金进行监管。公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司上海众硅提供不超过73,041.47万元的借款，用以实施高端半导体设备产业化项目与高端半导体设备研发中心项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程

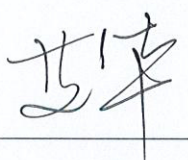
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

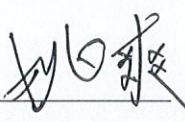
综上所述，本独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

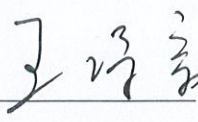
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中微半导体设备（上海）股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：


艾 华


姚 爽


王诗言

